

Datenblatt Herstellung Leiterplatten DKL

Basismaterialien	Standard FR4	
	min. Materialstärke	0,5 mm
	max. Materialstärke	3,2 mm
	min. End-Kupfer-Dicke	35 µm
	max. End-Kupfer-Dicke	105 µm
	T _g	130/150/170 °C
Layout	Strukturbreite	125 µm
	Strukturabstand	125 µm
	uml. Löstoplack-Freistellung	50 µm
	kleinster Löstoplack-Steg	150 µm
	kleinste Restringe	125 µm
	kleinste Bohrung (Via)	0,2 µm
	kleinster Fräsradius	250 µm
	kleinster Ritzwinkel	30 °
	Durchkontaktierung	> 20 µm
Oberfläche	Kantenmetallisierung	möglich
	HAL bleifrei	
	HAL SnPb	
	chem. Zinn	
	chem. Ni/Au	
Lötstopplack	chem. Ag	
	Hartgold, Bondgold	
	Carbondruck	
	grün / schwarz / blau / rot ...	
	superweiß (für LED- Anwendungen)	
Kennzeichendruck	Durchsteigefrüller	
	abziehbare Lötdeckmaske	
	Kaptonband	
Qualitätskontrolle	weiß / gelb / schwarz ...	
Daten	optische Kontrolle	
	AOI	
	elektrischer Test	
	Erstmusterprüfung	
Zertifikate / Normen	vorzugsweise Gerberdaten	
	Eagle	
	TARGET, PROTEL, Altium, etc.	
	ISO 9001:2015	
	UL	
	IPC-A-600	
andere Materialien und Ausführungen auf Anfrage		